

全自动PCB插件选择性波峰焊

产品名称	全自动PCB插件选择性波峰焊
公司名称	深圳市科圣达超声波自动化设备有限公司
价格	350000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道浪口二路92号3楼
联系电话	13823746941

产品详情

全自动PCB插件选择性波峰焊也称选择焊，应用PCB插件通孔焊接领域的设备，因不同的焊接优势，在近年的PCB通孔焊接领域，有逐步成为通孔焊接的流行趋势，应用范围不限于：军工电子、航天轮船电子、汽车电子、数码相机、打印机等高焊接要求且工艺复杂的多层PCB通孔焊接。

全自动PCB插件选择性波峰焊分为离线式选择性波峰焊和在线式选择性波峰焊两种

离线式选择性波峰焊：离线式即指与生产线脱机的方式，组焊剂喷涂机和选择性焊接机为分体式1+1，其中预热模组跟随焊接部，人工传输，人机结合，设备占用空间较小。

全自动PCB插件选择性波峰焊可以实时接收生产线数据全自动对接，组焊剂模组预热模组焊接模组一体式结构，特点是全自动链条传输，设备占用空间较大，适合自动化要求较高的生产模式。

全自动PCB插件选择性波峰焊其实与传统的波焊炉稍微有点不太一样，它其实是使用小锡炉喷嘴易于移动的特性，将[PCB板](#)

子固定于架上，然后移动放置于PCB底下的小锡炉锡液喷嘴，将小锡炉的焊锡液接触到THT或DIP传统插件零件的焊脚，来达到焊锡的效果。

全自动PCB插件选择性波峰焊的小锡炉喷嘴有点类似我们印象中涌泉的样子，熔融的锡液会从小锡炉喷

嘴的喷嘴涌流而出，也就是同波焊中的「扰流波」，达到焊锡传统通孔零件脚的目的，其焊锡的吃锡效果当然比SMT制程的通孔填充率来得好，几乎都可以1的填满，而且零件不需要耐高温到Reflow的温度，不过缺点当然是得避让小锡炉喷嘴空间。

全自动PCB插件选择性波峰焊特点：焊接时不需要特别的治具、过炉托盘。

通孔零件不需要使用耐Reflow高温的材料。使用一般波峰焊的条件即可。

焊接时可以获得良好的焊接品质与通孔填充率。

全自动PCB插件选择性波峰焊节省能源。不需要像波峰焊炉一般有个大锡炉，也不需要回焊炉那么长的加温区即可达到目的。

节省成本。不需要像波峰焊炉一样使用过多数量的锡条(Solder Bar)。

避让区比波峰焊制作过炉托盘来得小。

电路板不易因为高温而弯曲变形。

全自动PCB插件选择性波峰焊较传统波峰焊及SMT节省时间。

独创CCD扫描直视编程界面节省时间、生产路径可独立优化提高生产效力、可视化焊接补偿功能为操作者快速完成生产参数导入进行生产。

全自动PCB插件选择性波峰焊自定义的喷点大小和速度组合精确控制生产制程适合各种复杂焊接和品质要求

喷流式选择性波峰焊采用全自动在线生产模式,实现自动流水作业,

节省人工手涂助焊剂环节,高效高产能型生产工艺.适合大批量流水生产作业。

全自动PCB插件选择性波峰焊焊接质量

光从焊接质量的角度来看选择性波峰焊肯定是优于手工焊接的。虽然由于高品质智能性电烙铁的应用，手工焊接质量有了质的提高，但仍存在一些难以控制的因素。例如，焊点焊料量和焊接润湿角的把控，焊接一致性的掌握，金属化孔过锡率的要求等。尤其是当元器件引线是镀金时，就必须在焊接前对于需要进行锡铅焊接的部位进行除金搪锡，这是件很麻烦的事。

手工焊接还存在人为因素等弊病，难以满足高质量的要求；例如，随着电路板密度的提高及电路板厚度的增大，使得焊接热容量增大，烙铁焊接很容易导致热量不足，形成虚焊或通孔焊锡爬升高度不满足要求。如果过度提高焊接温度或延长焊接时间，易损伤印制电路板导致焊盘脱落。

全自动PCB插件选择性波峰焊焊接效率

传统的人工烙铁焊接，需要很多人对PCB采用点对点式的焊接。选择性波峰焊采用的是流水线式的工业

化批生产模式，不同大小的焊接喷嘴可以采用拖焊的批量焊接，通常焊接效率比人工焊接提高几十倍。

全自动PCB插件选择性波峰焊焊接灵活性

选择性波峰焊由于采用可编程可移动式的小锡缸和各种灵活多样的焊接喷嘴，所以在焊接时可以通过程序设定来避开PCB的B面某些固定螺钉和加强筋等部位，以免其接触到高温焊料而造成损坏，也无须采用定制焊接托盘等方式；因此，非常适合多品种、小批量的生产方式，尤其在航天航空和军工领域等行业有着非常广阔的应用前景！

选择性波峰焊的高品质

使用选择性波峰焊进行焊接时，每个焊点的焊接参数都可以“量身定制”，有足够的工艺调整空间把每个焊点的焊接条件，如助焊剂的喷涂量、焊接时间、焊接波峰高度和波峰高度调至佳，缺陷率可以大大降低甚至有可能做到通孔元器件零缺陷焊接，与手工焊、通孔回流焊和传统波峰焊相比，选择性波峰焊的缺陷率（DPM）是低的。

全自动PCB插件选择性波峰焊优势：

较小的设备占地面积

较少的能源消耗

大量的助焊剂节省

全自动PCB插件选择性波峰焊大幅度减少锡渣产生

大幅度减少氮气使用量

没有工装夹具费用的发生

全自动PCB插件选择性波峰焊整机内部同时有三件PCB板或治具分别在喷雾，预热及焊接处工作，提高机器整体产能。

独立的喷雾运动平台与独立的焊接运动平台。

焊接质量高，大幅提升焊接的直通率。

全自动PCB插件选择性波峰焊SMEMA在线运输，支持客户进行灵活组线。

全电脑控制，参数均在电脑上设定与保存。生成配置文件，便于追溯与保存

全自动PCB插件选择性波峰焊输送参数：

PCB宽度（mm）：30-350（拼板生产30-165）

PCB长度（mm）：50-310

PCB顶部高度（mm）：Max:50

PCB底部限高（mm）：Max:30

传送高度（mm）：900 ± 20

全自动PCB插件选择性波峰焊喷涂助焊剂参数：

助焊剂喷涂方式：液柱+喷雾

助焊剂容量：2-4L

喷涂液柱宽度：5-10mm

液柱喷头口径 0.25mm

全自动PCB插件选择性波峰焊喷雾宽度：15-30mm

喷雾口径：0.5-1.0mm

全自动PCB插件选择性波峰焊预热模块参数：

加热方式：红外线加热

加热功率：Max:2*4Kw

标准预热模组数量：二组分区预热

顶部加热：可选顶部红外加热/每组4Kw

加热温度范围：室温-180

预热温度控制精度：± 5

全自动PCB插件选择性波峰焊焊接参数：

锡炉容量：17Kg/炉*2

锡嘴小直径：直径5mm

波峰高度：3-8mm

锡炉温控: ± 2

全自动PCB插件选择性波峰焊焊接温度: Max:300

化锡时间 :40分钟260

锡炉加热功率 :2.5Kw/炉*2

焊接速度 :2-200mm/s

锡氧化量 :350g/炉/8小时

焊接精度 : ± 0.25 mm

氮气纯度: 99.99%

氮气消耗 :3立方米/炉/小时

全自动PCB插件选择性波峰焊设备参数 :

设备外观尺寸(长*宽*高) :2370*1730*1630

电源 :3P5W , 380VA——50、60Hz

大功率 :12Kw

使用功率 :6Kw

气源 0.5MPa

全自动PCB插件选择性波峰焊排风要求: 助焊剂单独排风 , 焊接区一个排风共2个排风口